

中信建投证券股份有限公司

关于

成都莱普科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐人



二〇二五年九月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王志伟、陈忱根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义	3
一、普通术语	3
二、专业术语	3
第一节 本次证券发行基本情况	5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人	5
二、本次证券发行项目的项目组其他成员	5
三、发行人基本情况	8
四、保荐人与发行人关联关系的说明	8
五、保荐人内部审核程序和内核意见	9
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查	10
第二节 保荐人承诺事项	14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查	15
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查	15
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查	15
第四节 关于发行人利润分配政策的核查	17
第五节 对本次发行的推荐意见	18
一、发行人关于本次发行的决策程序合法	18
二、本次发行符合相关法律规定	19
三、发行人的主要风险提示	23
四、发行人的发展前景评价	24
五、审计截止日后主要经营状况的核查情况	29
六、保荐人对本次证券发行的推荐结论	30

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

一、普通术语

中信建投证券、保荐人、主承销商	指	中信建投证券股份有限公司
发行人、公司、本公司、莱普科技	指	成都莱普科技股份有限公司
莱普有限	指	成都莱普科技有限公司，发行人前身
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
发行保荐书、本发行保荐书	指	《中信建投证券股份有限公司关于成都莱普科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书》

二、专业术语

激光	指	Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (LASER)，由粒子受激辐射产生的光束，具有良好的单色性、相干性、方向性和高能量密度的特点，广泛应用于各种工业制造及科研领域。
激光器	指	产生、输出激光的器件，是激光加工系统的核心器件。
光、机、电、算	指	光：采用先进光学设计，光束整形及光学监控系统，实现激光光束整形匀化，高精度调控，确保激光光学系统长期稳定可靠。
	指	机：基于精密机械结构设计，确保设备具备高稳定性和高定位精度，支持灵活的模块化配置。
	指	电：融合了高效率的电气控制系统，提供完善的电控解决方案和快速的信号处理能力。全方位的安全防护措施，进一步确保了设备和操作者的安全，提升了系统的可靠性和稳定性。
	指	算：利用智能化计算平台，支持实时数据采集分析及监控维护，优化生产和维护流程。
脉宽	指	激光功率维持在一定值时所持续的时间。
波长	指	激光光束在真空中传播的相邻波峰间距，不同波长表现为不同颜色。
热处理	指	一类半导体制程步骤，涉及将半导体器件或材料在控制温度下暴露于热环境中，以改变其性能、结构或其他特性。主要涉及晶体生长与结晶改善、应力控制、掺杂和扩散、氧化与退火、金属连接的形成等工艺。

激光热处理	指	一种利用激光束对材料进行局部加热和处理的技术，通常涉及使用高能激光束照射材料表面，以实现诸如热处理、改性、熔化、硬化等目的。
退火	指	一种半导体制程步骤，是通过将半导体材料加热到特定温度，然后在控制的环境下冷却，以改善晶体结构、消除缺陷或改变材料的性质。
激光退火	指	一种利用激光束对材料进行热处理的过程。通过控制激光束的功率和照射时间，可以实现对材料局部区域的加热和冷却，从而改变材料的结构和性质。
材料改性	指	通过物理、化学或生物手段对材料成分、微观结构及表面特性进行定向调控。

本发行保荐书除特别说明外，所有数值保留 2 位或 4 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

中信建投证券指定王志伟、陈忱担任本次成都莱普科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

王志伟先生：保荐代表人，硕士研究生学历。现任中信建投证券投资银行业务管理委员会执行总经理，曾主持或参与的项目有：南京国博电子股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目、江苏硕世生物科技股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目、芯原微电子（上海）股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目、中铝国际工程股份有限公司首次公开发行并在主板上市项目、创意信息技术股份有限公司首次公开发行并在创业板上市项目、西部证券股份有限公司首次公开发行并在中小板上市项目、辽宁成大股份有限公司非公开发行股票项目、江汉石油钻头股份有限公司非公开发行股票项目、创意信息技术股份有限公司发行股份购买资产项目等；目前，无作为保荐代表人尽职推荐的在审项目。王志伟先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

陈忱女士：保荐代表人，中国注册会计师，硕士研究生学历。现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目等；目前，无作为保荐代表人尽职推荐的在审项目。陈忱女士在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

二、本次证券发行项目的项目组其他成员

（一）本次证券发行项目协办人

本次证券发行项目的协办人为陈剑锋，其职业情况如下：

陈剑锋先生：保荐代表人，中国注册会计师，具有法律职业资格，硕士研究

生学历。现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，曾主持或参与的项目有：矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目等。陈剑锋先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）本次证券发行项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员包括：胡明勇、赵在华、翟佳俊、徐睿、刘牧谦、肖晨刚、李昊天、许正源、黄泽森。

胡明勇先生：保荐代表人，硕士研究生学历。现任中信建投证券投资银行业务管理委员会执行董事，曾主持或参与的项目有：武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目等。胡明勇先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

赵在华先生：保荐代表人，中国注册会计师，具有法律职业资格，硕士研究生学历。现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目等。赵在华先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

翟佳俊先生：保荐代表人，硕士研究生学历。现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理。翟佳俊先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

刘牧谦先生：保荐代表人，中国注册会计师，硕士研究生学历。现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：南京国博电子股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目、江苏硕世生物科技股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目、上海艾麒信息科技股份有限公司新三板挂牌项目、浙报数字文化集团股份有限公司重大资产重组项目等。刘牧谦先生在保

荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

徐睿女士：硕士研究生学历，具有香港证券从业资格。现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行并在创业板上市项目、珠海博雅科技股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目、蒙娜丽莎集团股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券项目、中科创达软件股份有限公司重大资产购买 Rightware Oy 项目、神思电子技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目、浙报数字文化集团股份有限公司重大资产出售项目、歌尔微电子股份有限公司香港主板上市项目（在审）等。徐睿女士在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

肖晨刚先生：保荐代表人，中国注册会计师，税务师，具有法律职业资格，硕士研究生学历。现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行并在创业板上市项目、广东基烁新材料股份有限公司新三板挂牌项目、黑龙江交通发展股份有限公司豁免要约收购项目等。肖晨刚先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

李昊天先生：保荐代表人，博士学历。现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目、宁波家联科技股份有限公司首次公开发行并在创业板上市项目、武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目等。李昊天先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

许正源先生：研究生学历。现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目、宁波家联科技股份有限公司首次公开发行并在创业板上市项目。许正源先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

黄泽森先生：保荐代表人，具有法律职业资格，硕士研究生学历。现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理。黄泽森先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

三、发行人基本情况

公司名称	成都莱普科技股份有限公司
注册地址	成都高新区康强三路 179 号
成立时间	2003 年 12 月 22 日
注册资本	4,818.00 万元人民币
法定代表人	叶向明
董事会秘书	唐昊
联系电话	028-88556028
互联网网址	http://www.la-ap.com
主营业务	莱普科技以先进精密激光技术及半导体创新工艺开发为核心，主要从事高端半导体专用设备的研发、生产和销售，并提供相关技术服务。公司主要产品包括激光热处理设备与专用激光加工设备两大序列，已广泛应用于 12 英寸集成电路产线、先进封装产线，是国内少数同时为半导体前、后道工序提供前沿激光工艺设备的厂商。
本次证券发行的类型	首次公开发行股票并在科创板上市

四、保荐人与发行人关联关系的说明

（一）截至本发行保荐书签署日，保荐人通过投资其他主体间接持有发行人股份，穿透后合计持股比例低于十万分之一。该等间接投资行为系相关间接层面投资主体所作出的独立投资决策，并非保荐人主动对发行人进行投资。除上述情况外，本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在其他持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）截至本发行保荐书签署日，除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐人或本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方的任何股份的情形；

（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在持

有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，或在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；

（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；

（五）保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

五、保荐人内部审核程序和内核意见

（一）保荐人关于本项目的内部审核程序

本保荐人在向中国证监会、上交所推荐本项目前，通过项目立项审批、投行委质控部审核及内核部门审核等内部核查程序对项目进行质量管理和风险控制，履行了审慎核查职责。

1、项目的立项审批

本保荐人按照《中信建投证券股份有限公司投资银行类业务立项规则》的规定，对本项目执行立项的审批程序。

本项目的立项于2024年1月30日得到本保荐人保荐及并购重组立项委员会审批同意。

2、投行委质控部的审核

本保荐人在投资银行业务管理委员会（简称“投行委”）下设立质控部，对投资银行类业务风险实施过程管理和控制，及时发现、制止和纠正项目执行过程中的问题，实现项目风险管控与业务部门的项目尽职调查工作同步完成的目标。

2025年4月22日至29日，投行委质控部对本项目进行了现场核查；2025年8月1日至8日，投行委质控部对本项目进行了第二次核查；2025年8月13日，项目组向投行委质控部提出底稿验收申请；底稿验收申请通过后，2025年8月14日，投行委质控部对本项目出具项目质量控制报告。

投行委质控部针对各类投资银行类业务建立有问核制度，明确问核人员、目的、内容和程序等要求。问核情况形成的书面或者电子文件记录，在提交内核申

请时与内核申请文件一并提交。

3、内核部门的审核

本保荐人投资银行类业务的内核部门包括内核委员会与内核部，其中内核委员会为非常设内核机构，内核部为常设内核机构。内核部负责内核委员会的日常运营及事务性管理工作。

内核部在收到本项目的内核申请后，于 2025 年 8 月 15 日发出本项目内核会议通知，内核委员会于 2025 年 8 月 22 日召开内核会议对本项目进行了审议和表决。参加本次内核会议的内核委员共 7 人。内核委员在听取项目负责人和保荐代表人回复相关问题后，以记名投票的方式对本项目进行了表决。根据表决结果，内核会议审议通过本项目并同意向中国证监会、上交所推荐。

项目组按照内核意见的要求对本次发行申请文件进行了修改、补充和完善，并经全体内核委员审核无异议后，本保荐人为本项目出具了发行保荐书，决定向中国证监会、上交所正式推荐本项目。

(二) 保荐人关于本项目的内核意见

本次发行申请符合《公司法》《证券法》、中国证监会相关法规规定以及上交所的有关业务规则的发行条件，同意作为保荐人向中国证监会、上交所推荐。

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查

(一) 核查对象

根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 4 号》规定，本保荐人对截至本发行保荐书签署日莱普科技在册股东中是否有私募投资基金及其是否按规定履行备案程序情况进行了核查。

(二) 核查方式

本保荐人履行的核查方式包括查阅发行人股东的股东名册、工商登记资料、营业执照、公司章程、合伙协议、备案登记资料、出具的说明文件以及通过中国证券投资基金业协会网站查询私募基金备案情况等。

（三）核查结果

截至本发行保荐书签署日，发行人在册股东中的私募投资基金履行备案程序的情况如下：

序号	股东名称	股东性质	私募基金编号	私募基金备案时间	私募基金管理人	私募基金管理人登记编号
1	国家集成电路基金二期	私募基金	SJU890	2020/3/12	华芯投资管理有限责任公司	P1009674
2	长存产投	私募基金	SABY22	2023/11/15	湖北国芯产业投资管理有限责任公司	P1062935
3	厦门石普	私募基金	SZB096	2023/2/9	北京石溪清流私募基金管理有限公司	P1068420
4	青岛琮碧	私募基金	SZA050	2023/3/2	深圳琮碧秋实投资管理有限公司	P1019549
5	全德学镡科芯	私募基金	SQN910	2021/6/9	全德学尔私募基金管理（上海）有限公司	P1071902
6	华西金智	私募基金	SLU695	2020/9/10	华西金智投资管理有限责任公司	GC2600030923
7	鼎创一号	私募基金	SSQ488	2022/5/30	株洲中车时代高新投资有限公司	P1061064
8	余姚石溪	私募基金	SZM584	2023/3/8	北京石溪清流私募基金管理有限公司	P1068420
9	青岛勤芯	私募基金	SACD37	2023/10/19	北京勤科投资管理有限公司	P1071011
10	泰达恒鼎	私募基金	SJV527	2020/7/3	天津泰达科技投资股份有限公司	P1001349
11	全德学四专芯	私募基金	SZK348	2023/3/8	全德学尔私募基金管理（上海）有限公司	P1071902
12	上海浦宸	私募基金	SABA07	2023/9/18	上海国盛资本管理有限公司	P1068692
13	无锡国联	私募基金	SNC431	2021/11/16	国联通宝资本投资有限责任公司	GC1900031594
14	淄博君恒	私募基金	SAEE48	2023/12/19	北京君恒私募基金管理有限公司	P1074002
15	浦东海望	私募基金	SQX812	2021/7/6	上海浦东海望私募基金管理有限	P1072004

序号	股东名称	股东性质	私募基金编号	私募基金备案时间	私募基金管理人	私募基金管理人登记编号
					公司	
16	鼎创二号	私募基金	SXY093	2023/1/17	株洲中车时代高新投资有限公司	P1061064
17	蓉创投资	私募基金	SVN300	2022/5/26	成都创新风险投资有限公司	P1022366

经核查，本保荐人认为，截至本发行保荐书签署日，莱普科技在册股东中的上述私募投资基金或私募投资基金管理人已按照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等文件规定履行了相关登记备案程序。

发行人其他 10 名机构股东包括东骏投资、东莞莱普、东莞聚慧、东莞骏峰、东莞天戈、东莞普英、广州山立、成都高投、西藏芯前沿、金智莱鑫，相关股东情况如下：

序号	股东名称	股东情况
1	东骏投资	股东为 2 名自然人
2	东莞莱普	发行人员工持股平台
3	东莞聚慧	合伙人为 4 名自然人
4	东莞骏峰	发行人员工持股平台
5	东莞天戈	合伙人为 11 名自然人
6	东莞普英	合伙人为发行人股东东骏投资、东莞莱普、东莞聚慧、东莞骏峰、东莞天戈
7	广州山立	合伙人为自然人王林和广州华芯盛景创业投资中心（有限合伙），广州华芯盛景创业投资中心（有限合伙）已完成私募基金备案
8	成都高投	国有股东
9	西藏芯前沿	上市公司佰维存储（688525.SH）全资子公司
10	金智莱鑫	发行人股东华西金智的员工跟投平台

注：广州山立的有限合伙人广州华芯盛景创业投资中心（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会备案，基金编号为 STG174，成立时间为 2021 年 11 月 29 日，备案时间为 2021 年 12 月 21 日，基金类型为创业投资基金，基金管理人为华芯原创（青岛）投资管理有限公司；华芯原创（青岛）投资管理有限公司已于 2016 年 11 月 11 日在中国证券投资基金业协会登记，登记编号为 P1060141。

根据发行人股东出具的确认声明及股东调查表并经保荐机构在中国证券投资基金业协会网站查询，前述 10 名机构股东出资来源不存在以非公开方式向不

特定对象（合格投资者）募集资金设立的情形，亦未委托私募投资基金管理人管理并进行有关投资活动，或者受托管理任何私募投资基金，不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》规定的私募投资基金管理人或私募投资基金，无需履行相关登记或备案程序。

第二节 保荐人承诺事项

一、中信建投证券已按照法律、行政法规和中国证监会的规定以及上交所的有关业务规则，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐莱普科技本次首次公开发行股票并在科创板上市，并据此出具本发行保荐书。

二、通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信建投证券作出以下承诺：

（一）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（六）保证发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

（九）中国证监会规定的其他事项。

第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查

根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）等规定，本保荐人就在投资银行类业务中有偿聘请各类第三方机构和个人（以下简称“第三方”）等相关行为进行核查。

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查

本保荐人在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为，不存在未披露的聘请第三方行为。

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查

本保荐人对发行人有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。经核查，发行人在律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等该类项目依法需聘请的证券服务机构之外，存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。

发行人聘请了募集资金投资项目可行性研究机构为本次公开发行并上市提供服务，具体情况如下：

（一）聘请的必要性

为合理论证本次公开发行并上市募集资金投资项目的可行性，发行人聘请上海和诚创芯企业管理咨询有限公司对本次公开发行并上市募集资金投资项目提供可行性研究报告的咨询服务。

（二）第三方的基本情况、资格资质和具体服务内容

上海和诚创芯企业管理咨询有限公司是专业从事咨询服务的公司，其具有相应的咨询服务资质，主要为发行人本次公开发行并上市提供可行性研究咨询服务。

（三）定价方式、实际支付费用、支付方式和资金来源

发行人与其通过友好协商确定合同价格，资金来源为自有资金，支付方式为银行转账。上海和诚创芯企业管理咨询有限公司服务费用为 13.50 万元（含税），

发行人已于 2024 年 4 月支付 6.75 万元。

经本保荐人核查，发行人相关聘请行为合法合规。

综上，发行人存在直接有偿聘请其他第三方的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）等规定。

第四节 关于发行人利润分配政策的核查

经过对发行人本次发行上市后适用《公司章程（草案）》的核查，保荐人认为：发行人建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，《公司章程（草案）》关于利润分配的决策机制符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》的规定，发行人的利润分配政策和未来分红规划重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，注重给予投资者持续、稳定、合理的投资回报，有利于保护投资者的合法权益；发行人的《公司章程（草案）》及招股说明书中对利润分配事项的规定和信息披露符合《监管规则适用指引——发行类第10号》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

第五节 对本次发行的推荐意见

中信建投证券接受发行人委托,担任其本次首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。本保荐人遵照诚实守信、勤勉尽责的原则,根据《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定,对发行人进行了审慎调查。

本保荐人对发行人是否符合证券发行上市条件及其他有关规定进行了判断、对发行人存在的主要问题和风险进行了提示、对发行人发展前景进行了评价,对发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市履行了内部审核程序并出具了内核意见。

本保荐人内核部门及保荐代表人经过审慎核查,认为发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市符合《公司法》《证券法》等法律、法规、政策规定的有关首次公开发行股票并在科创板上市的条件,募集资金投向符合国家产业政策要求,同意保荐发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市。

一、发行人关于本次发行的决策程序合法

(一) 董事会的批准

2025年8月8日,发行人召开第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市方案的议案》等关于发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。

(二) 股东大会的批准

2025年8月24日,发行人召开2025年第三次临时股东会决议,会议审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市方案的议案》等关于发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。

经核查,本保荐人认为,发行人已就本次首次公开发行股票并在科创板上市履行了《公司法》《证券法》及中国证监会规定以及上交所的有关业务规则的决策程序。

二、本次发行符合相关法律规定

（一）本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件

1、公司自整体变更设立以来，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，结合公司实际情况逐步建立了由股东会、董事会、监事会/审计委员会和经营管理层组成的法人治理结构，制定和完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》及《关联交易决策制度》等一系列公司治理制度，明确了股东会、董事会、监事会/审计委员会、总经理及董事会秘书的权责范围和工作程序，为公司法人治理结构的规范化运行提供了制度保证。

此外，发行人董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会，并制定了相应的工作细则，有效地保证了公司的规范运作和可持续发展，形成了科学和规范的治理制度。

综上所述，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

2、根据致同会计师出具的无保留意见的《审计报告》，公司 2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年第一季度营业收入分别为 7,414.56 万元、19,075.73 万元、28,102.42 和 3,662.77 万元，净利润分别为-938.22 万元、2,279.87 万元、5,491.16 万元和 68.32 万元。公司营业收入持续增长，并且实现盈利。

综上所述，发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

3、根据致同会计师出具的无保留意见的《审计报告》，发行人最近三年一期财务会计报告被出具无保留意见审计报告。

综上所述，发行人最近三年一期财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

4、根据发行人及其控股股东、实际控制人的说明、发行人提供的资料并经

保荐人的审慎核查，截至本发行保荐书签署日，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪。

综上所述，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

5、发行人符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件，符合《证券法》第十二条第一款第（五）项的规定。

（二）本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件

中信建投证券对发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市是否符合《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）规定的发行条件进行了逐项核查，核查结果如下：

1、经核查发行人工商档案、纳税资料、发起人协议等资料，发行人前身莱普有限成立于 2003 年 12 月 22 日。2021 年 8 月 11 日，莱普有限召开股东会作出决议，同意莱普有限整体变更为股份有限公司。莱普有限以截至 2021 年 6 月 30 日经审计的净资产 11,193,232.12 元为基础，折合为 10,000,000.00 股股份，每股面值 1.00 元，净资产超过股本部分计入资本公积；同日，莱普有限全体股东东骏投资、东莞莱普、东莞聚慧、东莞骏峰和东莞天戈签订了发起人协议。2021 年 9 月 1 日，公司完成工商变更登记。

经核查发行人《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等一系列公司治理制度，发行人相关会议文件，组织机构安排等资料，并访谈发行人高级管理人员，发行人具有完善的公司治理结构，依法建立健全股东会、董事会、监事会/审计委员会以及独立董事、董事会秘书、董事会专门委员会制度，相关机构和人员能够依法履行职责。

综上，本保荐人认为：发行人是依法设立且持续经营 3 年以上的股份有限公司，已经具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，

符合《注册办法》第十条的规定。

2、经核查发行人内部控制流程、内部控制制度、会计记录、记账凭证、致同会计师出具的无保留意见的《审计报告》、致同会计师出具《内部控制审计报告》等资料，并访谈发行人财务负责人，本保荐人认为：发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年一期财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告。发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制审计报告，符合《注册办法》第十一条的规定。

3、经核查发行人业务经营情况、工商档案、主要资产权属证明文件、控股股东、实际控制人调查表、致同会计师出具的无保留意见的《审计报告》等资料，并访谈发行人高级管理人员，本保荐人认为，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《注册办法》第十二条第（一）项的规定。

4、经核查发行人报告期内主营业务收入构成、重大销售合同、主要客户资料等资料，发行人最近两年内主营业务未发生重大变化；经核查发行人工商档案，聘请董事、高级管理人员的相关会议决议，核心技术人员的《劳动合同》，发行人最近两年内董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化，发行人核心技术人员稳定且最近两年内没有发生重大不利变化；经核查发行人工商档案，控股股东、实际控制人访谈文件等资料，最近两年发行人的实际控制人始终为叶向明、毛冬，未发生变更。控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。本保荐人认为：发行人主营业务、控制权、管理团队稳定，符合《注册办法》第十二条第（二）项的规定。

5、经核查发行人主要资产清单、主要资产权属证明文件、致同会计师出具的无保留意见的《审计报告》、发行人律师出具的《法律意见书》等资料，本保

荐人认为：发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《注册办法》第十二条第（三）项的规定。

6、经核查发行人主营业务情况，相关主管机构出具的有关证明文件，并经公开信息查询，本保荐人认为：发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策；最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；董事、取消监事会前在任监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形，符合《注册办法》第十三条的规定。

（三）本次证券发行符合《科创属性评价指引（试行）》《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》的规定

1、发行人符合科创板行业领域的规定

公司以先进精密激光技术及半导体创新工艺开发为核心，主要从事高端半导体专用设备的研发、生产和销售，并提供相关技术服务。

根据中国证监会发布的《上市公司行业统计分类与代码》，公司所处的行业为“专用设备制造业（C35）”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司从事的半导体器件专用设备制造为战略性新兴产业，被纳入战略性新兴产业“1 新一代信息技术产业-1.2 电子核心产业-1.2.1 新型电子元器件及设备制造-半导体器件专用设备制造”。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（上证发 2024 年 4 月修订），公司属于“第五条（一）新一代信息技术领域，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件等”列示的科技创新企业。公司符合科创板关于行业领域的要求。

2、发行人符合科创属性要求的规定

公司同时符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第六条科创属性规定的4项指标，符合科创板定位，具体指标情况如下：

科创属性评价标准一	是否符合	指标情况
最近三年研发投入占营业收入比例5%以上，或者最近三年研发投入金额累计在8,000万元以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2022年至2024年，公司研发投入合计9,797.04万元，占营业收入比例为17.95%，满足标准。
研发人员占当年员工总数的比例不低于10%	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至2024年12月31日，发行人研发人员62名，研发人员占当年员工总数的比例为22.38%，超过10%。
应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利7项以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至本发行保荐书出具日，公司已取得发明专利15项，应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利超过7项。
最近三年营业收入复合增长率达到25%，或者最近一年营业收入金额达到3亿元	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2022至2024年，公司营业收入分别为7,414.56万元、19,075.73万元和28,102.42万元，年复合增长率94.68%，超过25%。

公司符合国家科技创新战略、拥有关键核心技术等先进技术、科技创新能力突出、科技成果转化能力突出、行业地位突出、市场认可度较高。本保荐人根据公司情况与《科创属性评价指引（试行）》《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》等相关规定进行逐条比对，公司符合科创板定位要求。

三、发行人的主要风险提示

（一）客户集中度较高的风险

报告期各期，公司向前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为66.86%、65.89%、83.45%和97.67%，其中向客户A及其同一控制下的其他主体销售金额占当期营业收入的比例分别为18.86%、42.87%、67.86%和81.74%。公司的客户及产品结构日趋多元化，但仍存在对客户A及其同一控制下的其他主体收入占比较高，客户集中度较高的情况。

公司下游的晶圆制造产业兼具资本密集与技术密集特征，行业集中度较高，而公司激光热处理设备产品主要面向集成电路先进制程、三维异构集成等前沿高端应用领域，相关产能进一步集中于少数晶圆厂。且相较于国际设备厂商，公司业务规模相对较小，受制于融资渠道有限、资金实力不足、产能有限等因素，公司现阶段重点拓展并满足具有明确扩产预期的客户，导致公司业务呈现集中于国

内主流、头部半导体制造商的阶段性特征。若公司主要客户因自身技术更新、产业政策变化、市场竞争加剧等原因，导致其资本性支出下降，进而导致客户需求订单量下降，则公司业绩稳定性也会受到较大影响。此外，如果公司后续不能持续开拓新客户并转化为收入，将不利于公司未来持续稳定发展。

（二）经营业绩波动的风险

报告期各期，公司营业收入分别为 7,414.56 万元、19,075.73 万元、28,102.42 万元和 3,662.77 万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 -920.00 万元、2,177.26 万元、4,834.56 万元和 -53.32 万元。

半导体设备行业受下游市场需求波动的影响较大，如果未来市场竞争加剧、宏观经济景气度回落或者国家产业政策发生变化，下游客户对相关设备的需求量可能下降。此外，公司将保持对新产品和新技术的高研发投入，相关研发投入短期内将对公司经营业绩造成一定的影响。在以上因素影响下，不排除未来公司经营业绩出现波动甚至亏损的风险。

（三）技术迭代的风险

公司所处的半导体设备行业属于技术密集型行业，涉及机械、化学、电子、信息、材料和能源等多学科尖端技术的融合应用，具有较高的技术门槛，技术更新迭代较快。为满足下游客户高速迭代的工艺需求，半导体设备需要保持同步升级。若公司产品及技术研发升级节奏无法满足下游客户需求，可能导致公司市场竞争力下降，进而对公司经营业绩造成不利影响。

（四）市场竞争风险

公司经过多年发展，已在半导体先进激光工艺设备领域建立起了一定的竞争优势，但不排除未来出现更多竞争对手进入该领域。如果竞争对手开发出更具有市场竞争力的产品，或者提供更好的价格及服务，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等会受到不利影响。

（五）发行人实际控制人存在大额对外担保的风险

截至本发行保荐书签署日，发行人实际控制人叶向明、毛冬对东莞东骏电器

有限公司（以下简称“东骏电器”）、东莞市汉邦能源有限公司（以下简称“汉邦能源”）等其控制企业以外的第三方提供的担保债务本金余额为 7.41 亿元，其中东骏电器担保债务本金余额 5.57 亿元、汉邦能源担保债务本金余额 1.84 亿元。

就上述叶向明、毛冬为东骏电器提供担保的债务，东骏电器贷款资金专项用于建设东骏广场项目。东骏广场项目为位于广东省东莞市南城街道的商业、办公楼，其 1 号楼已取得《现售备案证书》（莞商房现证第 202400211 号）、2 号楼已取得《预售许可证》（东莞商房预证字第 202300102 号）。农业银行于 2025 年 9 月 17 日发布《中国农业银行股份有限公司东莞分行业务经营用房购置项目报名公告》，根据上述公告，农业银行拟采购业务经营用房，要求房产位于东莞市主城区，用途为办公、商业，建筑面积约 2.40-2.60 万平方米，报名截止日期为 2025 年 9 月 21 日。根据东骏电器说明，东骏广场项目房产各项指标均符合农业银行的采购要求并已完成报名；如果东骏电器成为农业银行上述业务经营用房购置项目选定的供应商，相关交易完成后，东骏电器将使用房产销售款偿还相关债务，发行人实际控制人担保责任将相应消减。

除公司股权外，发行人实际控制人叶向明、毛冬的其他资产主要包括两人通过东骏投资持有的东骏激光 63.44% 股权以及其他一级市场投资、房产、个人理财等。就叶向明、毛冬提供担保事项，两人承诺：“截至 2025 年 9 月 26 日，本人及本人的关联方未收到主债权人提出的任何要求承担担保责任的主张，无论该等主张是书面或其他形式。如因主债务人迟延履行主债务或其他违约事项导致主债权人主张本人对担保债务承担连带保证责任，本人将立即针对相关事项采取包括但不限于转让除东骏投资、莱普科技股权之外的其他资产（含东骏投资持有的东骏激光股权）等积极措施，并使用其他资产或其他自筹资金偿还担保债务，以避免相关违约事项对莱普科技造成不利影响，确保莱普科技的控制权稳定性”。

虽然发行人实际控制人叶向明、毛冬已作出上述承诺，但鉴于相关担保的主债务本金余额较大，如果担保债务逾期未偿还，主债权人主张叶向明、毛冬承担连带保证责任，而两人未能及时清偿担保债务，则存在两人持有的发行人控股股东东骏投资的股权被主债权人申请冻结、甚至被司法强制执行的风险。

四、发行人的发展前景评价

（一）发行人所处行业前景广阔

莱普科技以先进精密激光技术及半导体创新工艺开发为核心，主要从事高端半导体专用设备的研发、生产和销售，并提供相关技术服务。公司主要产品包括激光热处理设备与专用激光加工设备两大序列，已广泛应用于 12 英寸集成电路产线、先进封装产线，是国内少数同时为半导体前、后道工序提供前沿激光工艺设备的厂商。公司主营业务所处的激光热处理设备市场与专用激光加工设备市场前景广阔。

1、激光热处理设备市场

热处理与光刻、刻蚀、离子注入、薄膜沉积、清洗/抛光、金属化并列为半导体制造前道七大工艺步骤。IC Insights 数据显示，仅以常规热处理应用场景测算，在半导体设备市场中，热处理设备价值规模占比也已达到 3%，整体与离子注入设备（3%）、清洗设备（4%）、CMP 设备（4%）和涂胶显影（3%）相近。结合 SEMI 数据测算，2024 年度中国大陆热处理半导体设备市场规模已达 14.87 亿美元。

对于公司聚焦的激光热处理领域，该技术主要面向集成电路先进制程与各类新兴工艺架构和新兴材料，如三维堆叠、异构集成、第三代化合物半导体材料等。随着中国大陆半导体制造产业规模增长，叠加先进制程渗透率提升，激光热处理设备市场发展回归上行周期，QY Research 等机构数据显示，中国大陆是全球主要的激光热处理设备消费市场之一，2024 年市场规模为 16.95 亿元，预计 2030 年将达到 32.96 亿元，年复合增长率（CAGR）为 11.72%。

2、专用激光加工设备市场

先进精密激光技术凭借较强的灵活性和较高的工作效率，对于半导体领域的降本增效具有重要的意义；且其高精度特征匹配半导体精细化发展趋势，因此激光加工在半导体领域均具备广阔的应用场景。此外，消费电子等终端市场的需求牵引也成为精密电子、MLED 等领域产能扩充的重要推动力。

欧洲领先的光学技术贸易杂志，暨德国光子学会和德国应用光学学会官方出版物《Photonics Views》数据显示，中国工业激光设备市场占激光设备市场的比例为 62%，工业激光设备中有 12% 用于半导体/显示领域（不含切割）；另结合中国科学院武汉文献情报中心发布的《2024 中国激光产业发展报告》《2025 中国激光产业发展报告》中全国激光设备市场规模保守测算，2024 年我国半导体领域激光加工设备市场规模将达 65.38 亿元，2019 年至 2024 年期间年复合增长率达 5.96%。

（二）发行人在行业内具备较强的竞争优势

1、技术和研发优势

公司扎根先进精密激光技术，经过多年研发和技术创新已积累了较多行业经验、知识产权。核心研发团队拥有多年激光技术、半导体工艺领域的研发、生产、销售和管理经验。公司已在多年研发过程形成具备完整自主知识产权的核心技术体系，具备紧跟行业趋势和下游工艺需求升级而不断迭代设备产品的研发实力。

公司现已适配国内半导体产业技术特征开发了多款原创性产品，并推出多款对标国际一流水平的半导体专用激光工艺设备，打破国际厂商在国内市场长期垄断局面。报告期内，公司相关设备已部署于客户 A、客户 B、客户 C、华润微、士兰微、三安半导体、中车时代、客户 D、华天科技、达迩科技等主流半导体厂商的先进制程和先进封装产线，并成功应用于先进制程 3D NAND Flash 存储芯片、先进制程 DRAM 存储芯片、28nm 及以下先进制程逻辑芯片、SiC 功率芯片、沟槽栅型 IGBT 功率芯片、先进电源管理芯片、BSI-CCD 芯片量产，以及国产 HBM 芯片工艺研发等前沿应用场景。

2、核心产品模块自主研发优势

公司核心技术全流程覆盖光、机、电、算各个环节，具有自主定义激光器、光路整形系统、精密位移控制系统、自动控制系统等激光设备核心模块的能力，核心部件的自主研发水平具备显著优势，并由此形成更灵活、更具针对性的整机设计和制造能力。

公司采用模块化、标准化架构设计，现有量产设备的技术对于其他先进应用

领域具有良好的普适性。

3、客户前沿技术需求快速响应优势

公司的主要竞争对手包括美国的维易科、应用材料和日本的住友重工等，相对于这些境外竞争对手，公司具有区位优势，更加贴近中国大陆半导体产业链，且供应更加稳定。此外，公司专注于激光半导体设备业务，相对于多主业发展的竞争对手，业务专注度更高。

公司已逐步建立了一支人员稳定、技术基础扎实、拥有丰富行业应用经验，且同时具备市场经营理念的复合型人才队伍，可以对客户工艺开发、产品适配做出更积极响应。

4、行业地位及客户基础优势

凭借优秀的产品力与服务质量，公司目前已成为多家境内一流半导体厂商的设备供应商，相关客户具有明显的规模优势、技术优势，预期未来经营状况稳定，导入其供应链有助于为公司长久发展提供持续业绩支持。此外，通过领先客户的供应商体系认证对于公司品牌及产品推广也有积极的示范作用。

(三) 发行人制定了清晰的未来发展战略和发展规划

1、整体发展战略规划

公司长期致力于以科技创新助力国家半导体产业发展，已确立了“激光热处理设备和专用激光加工设备”双引擎可持续发展的战略。未来，公司将继续以先进精密激光技术为核心，通过高强度研发投入持续夯实公司技术实力，推进产品矩阵多元化发展和深度优化；同时积极扩大服务对象群体，丰富下游应用领域并提高市场占有率，以自主研发的先进精密激光技术助力维护国家半导体等关键产业链的安全与稳定。

2、未来规划采取的措施

(1) 推进创新常态化，布局前沿技术

公司将以市场需求为导向大力推进创新常态化。公司计划持续引入高层次研发人才，保持高强度研发投入，巩固创新的底层支撑；同时深度接触市场，确保

技术创新方向与产业界实际需求保持一致。

基于常态化创新机制，公司将紧密跟随行业前沿动态，布局前沿产业技术，针对激光和半导体制造领域的前沿理论持续开展技术研究及产品开发，加快推动产业转型升级。

（2）强化品牌效应，扩大市场覆盖

基于成熟的自主创新能力和领先的产品力，公司已在半导体领域激光热处理及激光加工市场建立良好口碑并初步形成品牌效应，实现多数客户重复采购。未来，公司将巩固现有客户关系，并借助已有的设备产品的成功应用案例进一步强化品牌效应，推广自身品牌并加快市场开发，开拓更多不同应用领域的领先客户。

此外，公司积极践行“走出去”战略，公司将通过积极兴建海外技术支持与营销网点的方式开拓海外市场。扩大海外市场覆盖，不仅有助于公司提高全球影响力，挖掘新的业绩增长点，也有助于公司强化研发实力，通过直接服务国际领先晶圆厂并与国际领先设备厂商直接展开竞争，进一步深化公司对先进半导体制造工艺的理解。

（3）充分发挥资本平台优势，加大资源整合力度

公司将充分利用本次 IPO 融资机会，合理、高效利用资本市场资金支持。公司已结合业务发展目标与市场需求等因素对募集资金运用做了充分论证，上市后公司将审慎推进募集资金使用。

未来，公司还将充分利用上市后的融资平台，为公司发展提供长期资金和产业资源支持，增强自身竞争力，提高国产半导体供应链稳定性水平，并同步实现股东利益最大化。

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况

公司财务报告的审计截止日为 2025 年 3 月 31 日。财务报告审计截止日至本发行保荐书签署日，公司所面临的国家产业政策、税收政策等未发生重大变化，公司总体经营情况良好，业务模式、行业市场情况及竞争趋势未发生重大变化，公司与主要客户、供应商的合作关系未发生重大不利变化，未发生其他可能影响

投资者判断的重大事项。

六、保荐人对本次证券发行的推荐结论

受发行人委托，中信建投证券担任其本次首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。中信建投证券本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行有关事项严格履行了内部审核程序，并已通过保荐人内核部门的审核。保荐人对发行人本次发行的推荐结论如下：

本次莱普科技首次公开发行股票并在科创板上市符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件中有关首次公开发行股票并在科创板上市的条件；募集资金投向符合国家产业政策要求；发行申请材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信建投证券同意作为莱普科技本次首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，并承担保荐人的相应责任。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于成都莱普科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书》之签字盖章页)

项目协办人签名: 陈剑锋
陈剑锋

保荐代表人签名: 王志伟 陈忱
王志伟 陈 忱

保荐业务部门负责人签名: 王炳全
王炳全

内核负责人签名: 张耀坤
张耀坤

保荐业务负责人签名: 刘乃生
刘乃生

总经理签名: 金剑华
金剑华

法定代表人/董事长签名: 刘成
刘 成



中信建投证券股份有限公司

2025年9月26日

附件：

保荐代表人专项授权书

本公司授权王志伟、陈忱为成都莱普科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人，履行该公司首次公开发行股票并在科创板上市的尽职推荐和持续督导的保荐职责。

特此授权。

保荐代表人签名： 王志伟 陈忱
王志伟 陈 忱

法定代表人/董事长签名： 刘成
刘 成

中信建投证券股份有限公司
2025年9月26日
1100000047459